

DATAPAQ
 DATAPAQ
 DATAPAQ
 DATAPAQ

DATAPAQ

Paleta de análisis de soldadura por ola

Medición fácil y exacta de su proceso de soldadura por ola



Paleta CS3070 con perfilador

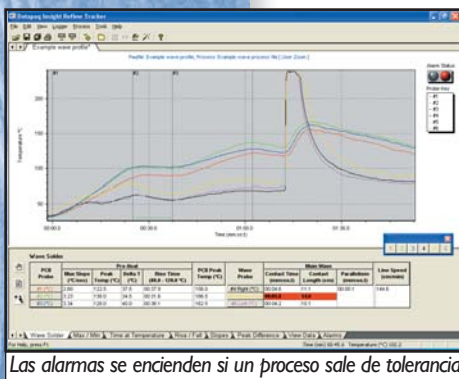
La más reciente innovación de DATAPAQ le permite analizar la mayoría de parámetros críticos de su proceso de soldadura por ola sin herramientas caras y complicadas. Usando la paleta de análisis de soldadura por ola de Datapaq, puede adaptar su sistema Reflow Tracker para obtener información exacta y repetible del proceso de ola. Entonces, el software Insight™ puede usarse para analizar datos de procesos de ola y reflujo, asegurando la compatibilidad de datos en toda la fábrica y minimizando las necesidades de capacitación del operador.

Puede ver todos los parámetros críticos del proceso de ola en una tabla de fácil lectura. Se visualizarán la ola, la ola del chip (si está presente) y los datos de precalentamiento, junto con el gráfico del perfil de temperatura.

El sistema es fuerte, confiable, asegura exactitud y repetibilidad sin el gasto de un analizador de ola dedicado.



Pantalla de resultados de soldadura por ola



Las alarmas se encienden si un proceso sale de tolerancia

Características de la soldadura por ola del software Insight:

El sistema de ola de Datapaq le permite obtener el perfil de todo el proceso de ola.

El análisis de precalentamiento incluye:

- Gradientes máximos
- Tiempos de subida
- Máxima temperatura en la zona de precalentamiento
- Delta T en la ola
- Máxima temperatura sobre la ola

El análisis de la ola incluye:

- Tiempo de contacto (izquierda, derecha y centro)
- Longitud de contacto (izquierda, derecha y centro)
- Paralelismo
- Velocidad del conveyor

Enciende una alarma si el perfil está fuera de tolerancia:

El software está configurado para encender una alarma, si los resultados están fuera de límites en la ola o en el área de precalentamiento.

Asistentes de Software:

Los Asistentes están diseñados para guiarlo paso a paso a través de un proceso particular y le dan la oportunidad de retroceder al paso anterior. Reducen el tiempo de capacitación de un operador nuevo.

Especificaciones técnicas

Datapaq le ofrece la máxima flexibilidad al seleccionar la forma de monitorear el proceso de ola:

- Paleta de soldadura por ola de Datapaq con tarjeta de muestra en PCB integrado - para monitoreo del proceso repetible.
- Paleta de soldadura por ola de Datapaq con restantes termopares conectados al producto del cliente para monitorear la estabilidad de la ola y las temperaturas reales de PCB/componente en el proceso.



Elija entre Panel de control de vidrio o Tarjeta de muestra PCB

Use el software de análisis Insight para monitorear procesos de soldadura por reflujo y soldadura por ola. Esto reduce las necesidades de capacitación para el operador en diferentes sistemas y asegura la consistencia de datos en el área de fabricación. El software es totalmente compatible con red, lo que permite compartir los datos del perfil dentro de la misma planta.

CS3070 Paleta de soldadura por ola equipada con 3 termopares y un tarjeta de muestra de PCB

Permite el monitoreo confiable y repetible de procesos de precalentamiento y soldadura por ola. Consta de la paleta equipada con las termopares PA1321, PA1320 y el tarjeta de muestra de PCB CS3072.

Dimensiones (Alt.xAnchoxLong.): 40mm x 300mm x 350mm
También puede equiparse con el Panel de control de vidrio para ola CS3071.

CS3071 Panel de control de vidrio para ola

Para uso con CS3070.

Permite una rápida revisión visual del contacto, longitud y uniformidad de la ola.

Dimensiones: 198mm x 130mm

CS3072 Tarjeta de muestra PCB

Equipada con 3 termopares tipo K. Para uso con CS3070.

Permite al sistema Datapaq medir las temperaturas de precalentamiento superior e inferior en el proceso de ola.

PA1320/I Termopares de ola

Termopares para uso en la paleta de soldadura por ola CS3070.

SW5060 Software Reflow Tracker Insight

La paleta de análisis de soldadura por ola está diseñada para uso con el software Reflow Tracker Insight. Es compatible con toda la variedad de perfiladores de datos Q18 con la excepción del DQ186I. Datapaq proporciona una amplia variedad de perfiladores de datos y barreras térmicas para adaptarse prácticamente a cualquier aplicación de reflujo o soldadura por ola. Contáctenos si desea mayor información.



www.datapaq.com

América del Norte y del Sur

DATAPAQ Inc.
187 Ballardvale Street
Wilmington, MA 01887
Tel: 1 (978) 988-9000
Fax: 1 (978) 988-0666
e-mail: reflow@datapaq.com

Europa/Asia

DATAPAQ Limited
Deanland House, 160 Cowley
Road,
Cambridge CB4 0GU, UK
Tel: +44 (0)1223 423 141
Fax: +44 (0)1223 423 306
e-mail: sales@datapaq.co.uk

